



Compression Molding System

Model CPM1080series



**Compression molding system
for high-precision WLP/PLP molding processes**



高精度WLP・PLP成形プロセスを実現する コンプレッションモールド装置

- HBM/2.5D/3D/ChipletおよびFOWLP/PLPなどの先端パッケージに最適
- モールド厚みの平坦度と到達真空度を向上し、より高品質な生産を実現
- 独自開発のコンプレッション技術を核に、ウェハレベルモールドとパネルレベルモールドに対応
- 1台の装置で顆粒樹脂と液状樹脂に対応 ※CPM1080-HPは顆粒樹脂と液状樹脂の選択式
- 独自の均一樹脂散布とパターンディスペンスに対応
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応

CPMseries
Wafer typeCPMseries
Panel type

CPM1080-HP

SPECIFICATION

Items		Unit	Description							
モデル		—	CPM1080		CPM1080-V		CPM1080-HP			
ワークタイプ		—	パネル・ウェハ							
ワークサイズ	パネル	mm	□150—320							
	ウェハ	mm	φ 320 (Max.)							
樹脂		—	顆粒・液状 (併用可)				顆粒 or 液状 (選択式)			
マシンタイム		sec	Approximately 88		Approximately 88		Approximately 65			
外形寸法	プレス数	module	1	2	1	2	1	2	3	4
	幅	mm	3,910	4,590	3,910	4,590	5,490	6,170	6,850	7,530
	奥行き	mm	2,180	2,180	2,180	2,180	2,168	2,168	2,168	2,168
	高さ	mm	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		ton	7.0	10.6	7.0	10.6	10.2	13.8	17.4	21.0
成形取り数		workpiece	1	2	1	2	1	2	3	4
マガジンスペース		—	Panel : Input / Output 2 cassette each Wafer : 2 loadport							
クランプ出力		kN/(tf)	98.0—784.0/10.0—80.0							
クランプ速度		mm/sec	100 (Max.)							
リリースフィルム幅		mm	440 (Max.)							

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。
- ・外形寸法は顆粒樹脂仕様のものに記載しています。

TOWA株式会社

【本社・工場】

〒601-8105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地

【海外販売拠点】

■中国

- ・TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
- ・Hechuang Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.

■台湾

- ・TOWA Taiwan Co., Ltd.

■韓国

- ・TOWA Korea Co., Ltd.

■シンガポール

- ・TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

■マレーシア

- ・TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

■タイ

- ・TOWA THAI COMPANY LIMITED

■フィリピン

- ・TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

■インド

- ・TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

■ドイツ

- ・TOWA Europe GmbH

■オランダ

- ・TOWA Europe B.V.

■アメリカ

- ・TOWA USA Corporation

